

実装フェスタ関西 2025 インパクトポスター賞

受賞:6件 おめでとうございます！

発表番号	受付番号	分野	演題名	発表者	所属
8	57	サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装	新しいパワー半導体材料 ルチル構造二酸化ゲルマニウム	松田 慎平 氏	Patentix株式会社
20	60	システムインテグレーション実装技術	ハイドロゲルを用いたフレキシブルFOWLP技術	佐藤 遼一 氏	東北大学
46	40	信頼性解析技術	はんだ付け性試験の濡れ性挙動に基づく新規前処理の検討	長居 秀幸 氏	TDK株式会社
38	18	材料技術	金属塩生成接合法を応用したフラックスレスはんだ付の検討	山崎 浩次 氏	群馬大学
14	39	三次元造形配線・実装応用技術	先端半導体パッケージ用ボンダーの開発	三原 健太郎 氏	東レエンジニアリング株式会社
19	52	システムインテグレーション実装技術	ハイブリッド接合に向けた接合挙動と絶縁膜表面の相関解析	尾形 峻太 氏	横浜国立大学

記念品:クリスタル置時計

